

Anlage 5: PCBA

Zutreffendes bitte ankreuzen, bzw. ausfüllen

1. Allgemein

Können alle Bauformen bestückt werden?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Welches Leiterkartenmaterial verwenden Sie am häufigsten?	<input type="checkbox"/> FR4	<input type="checkbox"/> FR5
	<input type="checkbox"/>	
Welches Lötverfahren wird verwendet?	<input type="checkbox"/> Reflow	<input type="checkbox"/> Dampfphasenlötverfahren
	<input type="checkbox"/> Schwalllötverfahren	<input type="checkbox"/> Handlötung
Beherrschen Sie das Verfahren der Einpresstechnik?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Können Sie Leiterkarten im Rapid Prototyping Verfahren herstellen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Welche Umwelttests können Sie durchführen?	<input type="checkbox"/> Shaker	<input type="checkbox"/> Temperatur
	<input type="checkbox"/> EMV	<input type="checkbox"/> Saltspray
Welche Prüfverfahren führen Sie durch?	<input type="checkbox"/> ICT	<input type="checkbox"/> AOI
	<input type="checkbox"/> EMV	<input type="checkbox"/> Röntgen
Ist eine Verdrahtung auf Geräteebene möglich?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein